

第二届新兴功能材料与器件研讨会

The 2nd Symposium on Emerging Functional Materials and Devices

关于召开2024“第二届新兴功能材料与器件研讨会”的会议通知

会议介绍：

随着现代科学技术的发展，在信息技术、新型材料、新能源等领域，特别是交叉融合方向正涌现出一批能够改变科技、经济、社会格局的颠覆性技术。新兴功能材料与器件就是在学科高度交叉融合基础上产生的新型创新与发展方向，特别是二维材料、光电功能材料、半导体材料、纳米材料与传感器件等开展研讨和学术交流，同时关注国内具有产业化和市场应用的关键技术发展等，是引领未来产业发展的重要因素之一。

在首届会议成功召开的基础上，“第二届新兴功能材料与器件研讨会”定于2024年11月29日-12月01日在南京市举行。本次大会专注新兴功能材料与器件的前沿领域，大会主题包括但不限于光电功能材料与器件、二维材料与器件论坛、半导体材料与光电子器件论坛、纳米材料与智能传感器件论坛。从学术和产业化视角去探讨我国新兴功能材料与器件的科研成果、所面临的机遇、挑战及未来发展方向，旨在促进科研创新以及研究人员与产业界人士间的交流合作。

为激发青年研究者对科学技术的热情，促进学术交流，本次大会将评选出数名“科学创新奖”与“最佳墙报奖”并颁发荣誉证书，欢迎广大青年研究者积极参会。此外，对于热爱研究的学生，本次大会还将评选出数名“优秀墙报奖”与“学术新锐奖”，并颁发荣誉证书。

欢迎各高校、科研院所、企事业单位的专家、学者出席本次会议。感谢您的支持！

现将会议有关安排告知如下：

- 会议主题：第二届新兴功能材料与器件研讨会
- 报到时间：2024年11月29日（周五9:00-23:00 - 签到、办理入住）
- 会议开始：2024年11月30日（周六）—— 大会开幕、大会报告、分论坛报告、颁奖活动
- 会议结束：2024年12月01日（周日）—— 分论坛报告、会议闭幕
- 会议地点：中国 · 南京
- 大会主席：施毅（南京大学） 王欣然（南京大学）
- 执行主席：王枫秋（南京大学）

一、组织机构：

名誉主席： 黄 维（西北工业大学） 张洪杰（清华大学） 王占国（中国科学院半导体研究所）

大会主席： 施 毅（南京大学） 王欣然（南京大学）

共同主席： 杨 槐（北京大学） 江 浪（中国科学院化学研究所） 郑子剑（香港理工大学）

赵德刚（中国科学院半导体研究所） 戴道铎（浙江大学） 赵 强（南京邮电大学） 王曾晖（电子科技大学）

执行主席： 王枫秋（南京大学）

组织委员： 吕俊鹏（东南大学） 孙 栋（北京大学） 杨 青（浙江大学） 徐淑宏（东南大学）

彭隆瀚（台湾大学） 张 京（宁波大学） 洪逸欣（新加坡科技设计大学） 丁翰元（西安电子科技大学）

楚 亮（杭州电子科技大学） 杨 睿（上海交通大学） 逢金波（济南大学） 赵为为（南京邮电大学）

周冰朴（澳门大学） 李云龙（中国科学院深圳先进技术研究院） 胡 亮（杭州电子科技大学）

主办单位： 先进材料与器件创新平台

指导单位： 南京大学 东南大学 清华大学

支持单位： 北京大学 浙江大学 宁波大学 上海交通大学 杭州电子科技大学 中国科学院半导体研究所

昇合彦（北京）信息技术有限公司 卓霖（张家口）信息技术有限公司

二、会议专题：

论坛一：二维材料与器件论坛

专题主席： 曾海波（南京理工大学） 周 鹏（复旦大学） 魏钟鸣（中国科学院半导体研究所）

倪振华（东南大学） 王曾晖（电子科技大学）

论坛二：光电功能材料与器件论坛

专题主席： 王建浦（南京工业大学） 邹德春（北京大学） 唐 江（华中科技大学） 杨 槐（北京大学）

闵永刚（广东工业大学） 彭茹雯（南京大学）

论坛三：半导体材料与光电子器件论坛

专题主席： 赵德刚（中国科学院半导体研究所） 单崇新（郑州大学） 段纯刚（华东师范大学）

万 青（甬江实验室） 孙晓娟（中国科学院长春光学精密机械与物理研究所）

论坛四：纳米材料与智能传感器件论坛

专题主席： 潘力佳（南京大学） 潘曹峰（北京航空航天大学） 彭争春（深圳大学） 黄晓（南京工业大学）

论坛五：青年科学家论坛

◆论坛目的：为激发青年研究者对科学技术的热情，为进一步汇聚优秀人才，组织青年科学家创新论坛。

◆奖项设置：青年学者“科学创新奖”+“最佳墙报奖”

欢迎各位专家、同仁，推荐优秀青年学者展示工作及参与论坛组织工作！

论坛六：研究生创新论坛

◆论坛目的：为了发现和培养人才，面向在读研究生，组织研究生学术论坛。

◆奖项设置：研究生“学术新锐奖”+“优秀墙报奖”

欢迎各位专家、同仁，推荐学生展示工作及参与论坛组织工作！

三、支持期刊：

1、Journal of Semiconductors

Journal of Semiconductors(中文刊名《半导体学报》),是中国科学院主管、中国科学院半导体研究所和中国电子学会主办的学术刊物,1980年以中文创刊,2009年改为全英文刊,主编为李树深院士,报道半导体物理、材料、器件、集成电路、工艺及相关领域内的最新科研成果和技术进展。月刊,今年首获IF为5.1,在凝聚态物理学科排名20/76,位列Q2区。目前被EI、ESCI、Scopus、INSPEC、CSTPCD、CSCD、WAJCI等国内外重要数据库收录。入选“中国科技期刊卓越行动计划”,连续8年荣膺“中国最具国际影响力学术期刊”。

2、Nano-Micro Letters

《纳微快报(英文)》(Nano-Micro Letters)是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(openaccess)出版的英文学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高原创性高质量研究文章和综述评论等文章,内容包括但不限于:微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、传感、环境、类脑器件、生物医学等领域的基础与应用研究。NML期刊已被SCI、EI、SCOPUS、PubMed Central、知网、万方等数据库收录。2023年公布的影响因子IF达到26.6,JCR排名在纳米、材料、物理三个学科位居Q1区前5%,也是中科院期刊分区大区(材料科学)和三个分区(纳米、材料、物理)1区期刊。

快速评审,专业编校,多渠道展示——NML编辑部不断追求卓越,提升科研服务水平。欢迎大家咨询、关注并支持NML期刊,欢迎投稿。详情可浏览期刊网站(<http://springer.com/40820>)和微信公众号(nanomicroletters)。

3、International Journal of Extreme Manufacturing

《极端制造(英文)》(International Journal of Extreme Manufacturing, IJEM)期刊由中国工程物理研究院主管,中国工程物理研究院机械制造工艺研究所(第一主办单位)、大连理工大学等单位共同主办。期刊具有多学科交叉特色,秉承聚焦、体系、专业、前沿、国际化的办刊方针,致力于发表极端制造相关高质量最新研究成果,在极端制造相关学科之间搭建一座沟通的桥梁,促进极端制造领域快速发展。2023年期刊最新影响因子14.7,在JCR报告工程制造领域排名第1,入选中科院期刊分级目录

工程技术1区、中国最具国际影响力学术期刊（TOP5%）。

期刊网址：<https://iopscience.iop.org/journal/2631-7990>

投稿链接：<https://mc04.manuscriptcentral.com/ijem-caep>

4、iScience

科学领域还存在许多重大的未解之谜。为了解决这些问题，科学家们需要跨学科进行合作。iScience的目标是促进这种跨学科思维。作为Cell子刊，iScience为生命、物理、地球和健康科学的各自的原创研究和交叉科学研究提供了一个重要平台。在iScience中发表的主要标准是对相关领域的重要贡献，以及具有可靠结果和基础方法，涵盖了这一跨学科领域的基础和应用研究的进展。iScience致力于发布顶级原创研究，坚持STAR Methods方法论模板，并通过专业的编辑团队提供公平快速和严格的同行评审流程。

官方网站：<https://www.cell.com/iscience/home>

5、Nano Research Energy

Nano Research Energy (ISSN:2791-0091; e-ISSN:2790-8119, Nano Research姊妹刊) 于2022年3月由清华大学创办，香港城市大学支春义教授和清华大学曲良体教授共同担任主编。是一本国际化的多学科交叉，全英文开放获取期刊，聚焦纳米材料和纳米科学技术在新型能源相关领域的前沿研究与应用，对标国际顶级能源期刊，致力于发表高水平的原创性研究和综述类论文，已入选2022年度中国科技期刊卓越行动计划——高起点新刊项目。

官方网站：<https://www.sciopen.com/journal/2790-8119>

四、会议注册（注册以缴费时间为准）

报名注册日期	普通参会	学生	企业代表	会员
2024年10月15日之前	2200	1500	3000	2000
2024年11月15日之前	2500	1600	3200	2300
现场注册缴费	3000	1800	3500	2800
付款方式（汇款账户信息）：				
名称：昇合彦（北京）信息技术有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京宣武门支行 银行账号：0200 2032 0920 0047 067		名称：卓霖（张家口）信息技术有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司张家口桥西支行 银行账号：0412 0413 0930 0480 747		

五、企业服务

赞助服务及回报方案		
本次会议设置展位展示宣传，欢迎各位专家同仁推荐仪器、设备、软件、供应商参会、参展		
赞助项目	费用	服务
展位赞助	12000	标准展位 1 个；免 2 人参会注册费；会刊内页展示（1 页）；易拉宝 2 个（自带）等
其他赞助	详细服务条款请见赞助方案	

六、参会须知：

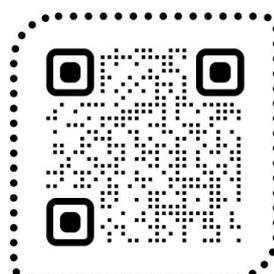
- 1、论坛组成：大会论坛+主题分论坛+青年科学家论坛
- 2、报告组成：大会报告、特邀报告、邀请报告、口头报告、墙报（90cm*120cm）、企业报告
- 3、摘要/报告/墙报提交截止时间：2024年11月20日（格式要求及模板详见回执或官网下载）
- 4、请提前将行程信息（自驾/车次/航班）发送至会务组，现场持嘉宾证入场。
- 5、为了答谢各位专家、老师、同学以及赞助商的支持，本次会议安排了答谢礼品，请到会议签到处领取。
- 6、食宿自理，如需安排住宿，回执内填写也可联系会务人员预定。
- 7、发票：统一开具为增值税普通发票，专票请提前说明，有其他问题可随时沟通会务组提前汇款，纸质发票现场统一发放（提前邮寄请说明），现场缴费会议结束后3日-7日内开具。
- 8、关于注册退费问题的说明：如有退款需求，相关事宜必须在11月15日（含）前申请办理，组委会将从缴费金额中扣除200 CNY/人作为相应的退款手续费；2024年11月25日后组委会将不办理任何退款，请悉知！如报名参会者由于特殊原因不能出席，可指派其他老师/学生参加，并在25日及时告知组委会更新报告及房间安排信息。

七、咨询及报名

会议会务组： 吴 洁 联系方式：13031085775（VX同号） 邮箱：jwu_xcl@qq.com



会议公众号



会议网站